

2019年11月28日

## 半導体事業の譲渡について

パナソニック株式会社(以下、「当社」)は本日付の取締役会決議により、当社100%出資の連結子会社であるパナソニック出資管理合同会社(以下、「PEMJ」)の100%出資連結子会社であるパナソニック セミコンダクターソリューションズ株式会社(以下、「PSCS」)を中心に運営している半導体事業を、台湾に本社を置く半導体企業であるWinbond Electronics Corporation傘下のNuvoton Technology Corporation(以下、「Nuvoton」)に譲渡(以下、「本件譲渡」)すること、ならびに同社との間で株式資産譲渡契約(以下、「本契約」)を締結することを決定しましたので、以下の通りお知らせいたします。

### 1. 背景および目的

当社の半導体事業は、過去数年来、AV分野から車載・産業分野へのシフトとともに、イメージセンサなどの「空間認識」技術と、バッテリーマネジメント用ICやリチウムイオン電池保護回路用MOSFETなどの「電池応用」技術を注力分野と位置付け、これらの分野にリソースを集中することで事業成長を目指してきました。

一方で、2014年4月に北陸工場(魚津・砺波・新井)の半導体ウェハ製造工程を、イスラエルの半導体ファウンドリ企業タワーセミコンダクター社との合併会社に移管しました。さらに同年6月にはシンガポール、インドネシアおよびマレーシアに保有していた半導体組立工場を、香港に本社を置くUTACマニュファクチャリングサービシーズ社(以下、「UTAC社」)へ譲渡しました。その後も国内外拠点の統廃合を行い、アセットライト化による事業リスクの低減を図り、競争力の強化に取り組んできました。

しかしながら、近年の競合他社の勢力拡大、注力事業への巨額投資、M&Aを通じた業界再編の進行等、半導体事業を取り巻く競争環境は熾烈を極めてきております。このような中、今後当該事業を成長拡大させるためには事業運営の強化と継続した投資が極めて重要となります。

かかる背景により今回、当社が蓄積してきた技術力、商品力を高く評価し、それらを最大限活用し、持続的な事業成長が期待できるNuvotonの下での事業運営が最善と判断し、本件譲渡を決定しました。

### 2. 本件譲渡について

(1)譲渡前事業再編: 当社は本件譲渡の直前に次の通り半導体事業の再編を行います。

- ①PEMJの完全子会社であるパナソニック デバイスシステムテクノ株式会社(以下、「PIDST」)、パナソニック デバイスエンジニアリング株式会社(以下、「PIDE」)の全株式を、会社分割によりPSCSに承継させます。

- ②当社および当社子会社が保有する半導体事業関連の知的財産権および契約の一部、ならびに当社が保有する半導体事業関連資産・負債の一部を、会社分割または資産譲渡によりPSCSに承継させます。
- ③PEMJが保有するPSCSの全株式を、新たに設立するPEMJの完全子会社(以下、「PSCS持株会社」)に株式譲渡により承継させます。
- ④PSCSの半導体関連部品(リードフレーム)事業を会社分割により新たに設立するPEMJの完全子会社に承継させます。

(2)本件譲渡の内容:上記「譲渡前事業再編」を前提に、2020年6月1日を効力発生日(予定)として、次の通り本件譲渡を実施します。

- ①PEMJは譲渡前事業再編後のPSCS持株会社の全株式をNuvotonに譲渡します。
- ②当社が子会社を通じて保有しているシンガポール法人パナソニック アジアパシフィック株式会社(以下、「PA」)において、半導体の開発・販売事業を担当する社内カンパニーであるパナソニック デバイスセミコンダクターアジア(以下、「PIDSCA」)の事業を、Nuvotonのシンガポール法人に譲渡します。
- ③パナソニック セミコンダクター蘇州有限会社(以下、「PSCSZ」)の半導体事業に係る設備・在庫等をNuvotonの中国法人に譲渡します。

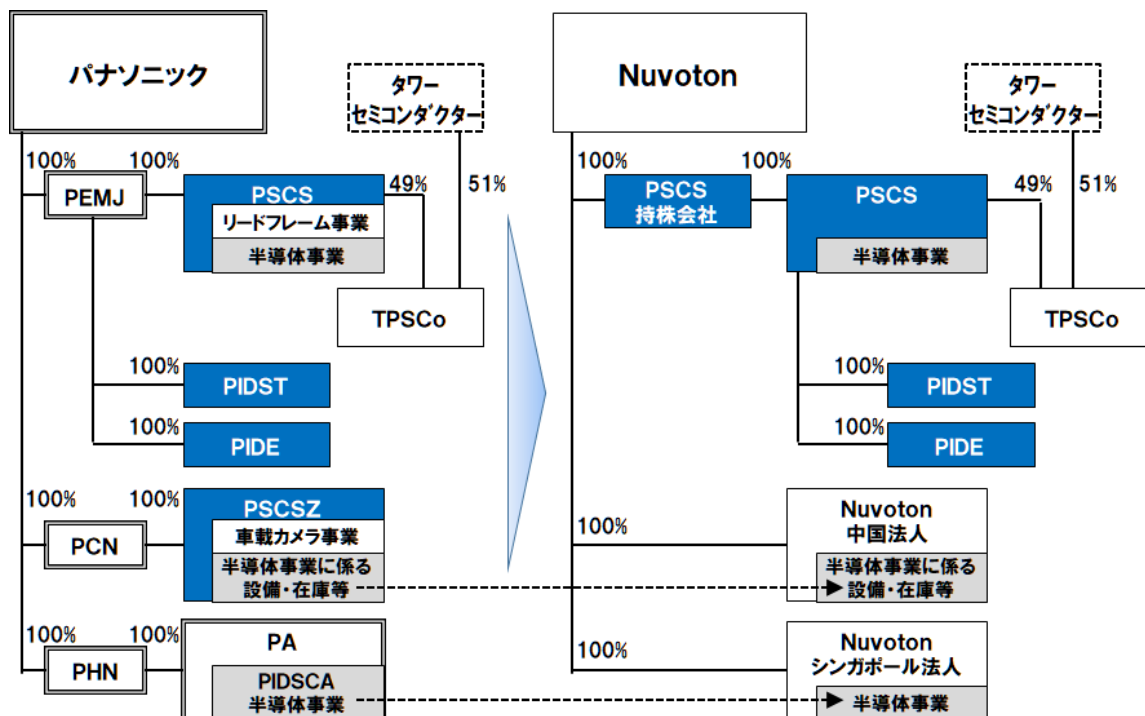
### 3. その他

本契約は、各国・地域の競争法当局その他政府機関の承認取得を前提としております。また、譲渡前事業再編を含む本件譲渡の実行予定日は、当該承認取得およびその他の許認可等に関する手続きにかかる期間を踏まえ大きく異なる可能性があります。

以 上

<ご参考>

【本件譲渡による資本関係の変化】



- ・PCN: パナソニック チャイナ
- ・PHN: パナソニック ホールディングオランダ
- ・TPSCo: パナソニック・タワージャズ セミコンダクター

**【当社半導体事業の沿革】**

1957年	・松下電子工業(フィリップス社との合併会社)高槻工場において半導体生産開始
1968年	・長岡工場(京都府長岡京市、現 PSCS本社所在地)稼働。シリコンランジスタ/バイポーラIC量産開始
1970年	・MOS LSI量産開始
1993年	・フィリップス社との合併を解消し、松下電器産業(現 パナソニック)の100%子会社に
2001年	・松下電器産業が松下電子工業を吸収合併
2014年	・タワーセミコンダクター社と拡散工程の合併会社設立 ・UTAC社へマレーシア、シンガポール、インドネシアの組立工場を譲渡
2015年	・ソシオネクスト社へシステムLSI事業を移管
2019年	・ディスクリート半導体事業をローム社へ譲渡(予定)

**【パナソニック セミコンダクターソリューションズ株式会社の概要】**

名称	パナソニック セミコンダクターソリューションズ株式会社
所在地	京都府長岡京市神足焼町1番地
代表者	代表取締役社長: 小山 一弘
事業内容	半導体および関連部品の開発、製造、販売
設立	2014年3月10日
資本金・出資	4億円 パナソニック出資管理合同会社100%

**【パナソニック デバイスシステムテクノ株式会社の概要】**

名称	パナソニック デバイスシステムテクノ株式会社
所在地	京都府長岡京市神足焼町1番地
代表者	代表取締役: 中澤 省吾
事業内容	半導体関連の設計、開発
設立	1997年1月10日
資本金・出資	2億円 パナソニック出資管理合同会社100%

【パナソニック デバイスエンジニアリング株式会社の概要】

名称	パナソニック デバイスエンジニアリング株式会社
所在地	富山県魚津市東山800番地
代表者	取締役社長：梶原 大平
事業内容	半導体関連の技術業務請負
設立	2000年3月1日
資本金・出資	2億円 パナソニック出資管理合同会社100%

【パナソニック デバイスセミコンダクターアジアの概要】

名称	パナソニック デバイスセミコンダクターアジア 英文名：Panasonic Industrial Devices Semiconductor Asia
所在地	シンガポール
代表者	社長：下茂 智博
事業内容	半導体の開発、販売
設立	1978年12月1日
備考	パナソニック アジアパシフィック株式会社の社内カンパニー

【パナソニック セミコンダクター蘇州有限会社の概要】

名称	パナソニック セミコンダクター蘇州有限会社 中文名：蘇州松下半導体有限公司
所在地	中国 江蘇省 蘇州市高新区鹿山路666号
代表者	董事長：小山 一弘
事業内容	半導体の製造、販売 車載カメラの製造
設立	2001年12月29日
資本金・出資	95億円 パナソニック チャイナ有限会社100%

【Winbondの概要】

名称	Winbond Electronics Corporation 華邦電子股份有限公司
所在地	台中市42881大雅區中部科學園區科雅一路8號
代表者	董事長：アーサー・チャオ(焦佑鈞)
事業内容	スペシャルティDRAM、コードストレージ用フラッシュメモリICの製品設計、研究開発、ウェハ製造
設立	1987年9月29日
資本金・出資	398億台湾ドル Walsin Lihwa Corporation 22.01%, Chin Xin Investment 5.0%

【Nuvotonの概要】

名称	Nuvoton Technology Corporation 新唐科技股份有限公司
所在地	新竹市東区新竹科学工業園區研新三路4号
代表者	社長：ショーン・タイ(戴尚義)
事業内容	ロジック集積回路(「IC」)の研究、設計、開発、製造、販売及び6インチウェハの製造、試験、OEM
設立	2008年4月9日
資本金・出資	73億5,800万台湾ドル Winbond Electronics Corporation 61.55%